

# 联络人

投资人关系 +886 3397 5999 ext. 1204 ir@winfoundry.com

# 稳懋半导体公告 2019 年第二季自结财务报告

2019年7月30日

稳懋半导体,全球最大砷化镓晶圆代工服务公司,已于今(30)日公告 2019 年第二季自结财务报告。

## 2019 年第二季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 44.51 亿元, 较前季增加 23%, 较去年同期减少 3%
- ◆ 本季合并毛利率为 34.0%,较前季增加 9 个百分点; 本季营业净利率 20.6%,较前季增加 12.3 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 9.18 亿元, 较前季增加 206%, 较去年同期减少 3%
- ◆ 本季税后净利为新台币 7.74 亿元,较前季增加 413%,较去年同期减少 15%;每股盈余为新台币 1.87 元,前季为新台币 0.41 元

# 2019 年第三季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期,但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第三季营收预计较第二季成长 30%上下。
- ◆ 第三季毛利率预计可望优于第二季的水平。

# 管理者评论

"2019年第二季稳懋营收达新台币44.5亿元,季成长率及年成长率分别为+23%及-3%,超过稳懋原先的预期,主要是因为亚洲的智能型手机相关PA设计公司客户自第一季末开始增温且在第二季动能逐渐放大,再加上因应第三季智能型手机终端新机发表的需求,相关客户备货开始启动所致。上半年累积营收达新台币80.7亿元,虽然仍比去年同期减少约一成的水平,但在历经了连续三季的产业低迷之后,六月营收年成长转为正数等于正式预告了旺季的到来,而稳懋月产能也在季底达到36,000片,为旺季做好准备。稳懋产能利用率自第一季的50%上升到第二季的80%,使得第二季毛利率如预期的自第一季谷底翻升来到34%的水平。随着毛利率上升,第二季营业净利率来到20.6%的水平,EPS达到新台币1.87元。

综观下半年,稳懋因长期布局全球众多fabless(无晶圆厂)客户,将持续受惠。虽然今年至今发表的5G手机并不多,但是我们相信5G需求即将到来,随着各国5G服务陆续上路,可望带动更多智能型手机制造商推出更多5G手机,稳懋与多个客户的5G PA早已完成开发,今年上半年已有少量出货。在此同时,我们已经先观察到5G相关的基础建设动能转强,稳懋infrastructure的营收在上半年的年成长幅度已大于四成,下半年也不看淡。

展望2019年第三季,我们预计营收将较第二季成长30%上下,预计毛利率可望优于第二季的水平。"

#### 关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年,位于林口华亚科技园区,是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路 (GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路 制造技术及生产设备,客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外,并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面,稳懋以多元化及领先为原则,期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中,稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术: 异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT),二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中,稳懋更以 MMIC 生产技术为基础,提供光电产品的开发与生产制造。

### 免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期,但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外,公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。